

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **106 (1988)**

Heft 37

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

Böden und Bodenbeläge

EMPA/SIA-Studientagung

EMPA und SIA organisieren gemeinsam am Mittwoch, 14. September 1988, 9.30 bis 17.15 Uhr, eine Studientagung, die sich an Architekten, Bauingenieure und Unternehmer richtet. Sie findet statt an der ETH Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 101, Zürich, Hörsaal E 7.

Ziel:

- Aufzeigen der Probleme, die bei Böden und Bodenbelägen auftreten
- Präsentation von fachgerechten Lösungen
- Einführung in die neuen SIA-Normen in diesem Bereich. Erläuterungen der darin enthaltenen Erfahrungen aus der Praxis.

Programm:

9.30: Begrüssung (U. Meier); Bauphysik der Bodenkonstruktionen (R. Sagelsdorff); Akustik (G. Stupp); Elektrostatik, Erdableitung (Dr. T. Zimmerli); Bodenheizungssysteme (E. Ballmer); Kaffeepause; Die neuen SIA-Normen (P. Ehrensperger); Schwimmende Unterlagsböden (H. Eppe); Bodenbeläge aus Textilien (E. Martin); Diskussion; Mittagspause. 13.45: Konstruktion und Durchbildung von Bodenplatten (H. Eppe); Bodenbeläge aus Hartbeton und magnesiasgebundene Bodenbeläge; Böden aus Vakuumbeton (R. Liniger); Bodenbeläge aus PVC und Linoleum (Dr. P. Pagani); Kaffeepause; Kunstharzbodenbeläge (C. Schellenberg); Bodenbeläge aus Holz (M. Mayer); Platten- und Natursteinbeläge (K. Kolonko); Diskussion. 17.15: Ende der Tagung

Referenten:

E. Ballmer, Heizungsingenieur SWKI, Techn. Leiter, Gebr. Tobler AG, Urdorf; P. Ehrensperger, Architekt ETH/SIA, Inhaber Architekturbüro, Bern; K. Eppe, Bauingenieur ETH, Abteilungsleiter, Gruner AG, Basel; K. Kolonko, Oberingenieur, SKS Technik Säure- und Korrosionsschutz GmbH, Göppingen BRD; R. Liniger, Vizedirektor, Euböolithwerke AG, Olten; E. Martin, Physiker ETH, Sektionschef, EMPA, St. Gallen; M. Mayer, Ingenieur FH, Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen; U. Meier, Bauingenieur ETH, Vizedirektor EMPA, Dübendorf; Dr. P. Pagani, Ingenieurchemiker ETH, Entwicklungsleiter, Forbo-Giubiasco SA, Giubiasco; R. Sagelsdorff, Bauingenieur ETH/SIA, Sektionschef Abt. Bauphysik, EMPA, Dübendorf; C. Schellenberg, Chemiker HTL, Geschäftsführer, Radix AG, Steinebrunn; G. Stupp, Maschineningenieur HTL/SIA, Leiter Gruppe Bauakustik, EMPA, Dübendorf; Dr. T. Zimmerli, Sektionschef Abt. Physik, EMPA, St. Gallen.

Tagungsbeitrag:

Mitglieder SIA Fr. 160.-, Nichtmitglieder Fr. 200.-. Im Tagungsbeitrag sind inbegriffen: Dokumentationsband SIA D 032, Böden und Bodenbeläge. Mittagessen in der Mensa. Pausenkaffee.

Bei Rückzug einer Anmeldung wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 50.- erhoben. Im Verhinderungsfall muss der Teilnehmerschein bis spätestens 13. September 1988 an das SIA-Generalsekretariat zurückgeschickt werden. Andernfalls wird der ganze Tagungsbeitrag verrechnet.

Wir bitten Sie, den Tagungsbeitrag nach Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung auf PC 80-5594-0 einzuzahlen.

Tagungsunterlagen:

Als Unterlage zur Tagung dient der Dokumentationsband SIA D 032, Böden und Bodenbeläge, der jedem Teilnehmer an der Tagung abgegeben wird und im Tagungsbeitrag inbegriffen ist.

Teilnehmerschein:

Der Teilnehmerschein wird zusammen mit der Anmeldebestätigung und Rechnung zugesandt.

Auskunft und Anmeldung:

SIA-Generalsekretariat, Postfach, 8039 Zürich, Tel. 01/201 15 70, Telefax 01/201 63 35.

Informatik im Bauwesen

Neuaufgaben rechtzeitig auf die Swissdata

Der SIA hat seine wichtigsten Publikationen auf dem Gebiet der Einführung in die EDV und seine Kataloge und Übersichtswerke in der Reihe «Informatik im Bauwesen» zusammengefasst. Die Publikationen werden regelmässig auf den neuesten Stand gebracht und neu aufgelegt. Rechtzeitig auf die Swissdata 1988 liegen die neuesten Ausgaben vor.

D 501 Einführung der EDV im Projektierungsbüro

Definiert die Grundbegriffe der EDV und gibt Hinweise und Ratschläge für die Evaluation bei der Einführung der EDV im Architektur- und Ingenieurbüro. Zweisprachig, 28 Seiten.

D 502 SIA Systemkatalog Administration

Aktuelle Übersichtstabellen über Soft- und Hardware mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Organisation und Administration des Projektierungsbüros sowie mit Programmen für den Bauingenieur. Enthält Kostenangaben. Dient für die Vorauswahl bei der Einführung der EDV als Ergänzung zum Band D 501. Detaillierte Angaben über die Programme sind im Software-Katalog enthalten. Zweisprachig, 32 Seiten, 5 Falttabellen.

D 503 SIA Software-Katalog

Jährliche Ausgabe. Als zentraler Teil der Publikationsreihe Informatik orientiert er die planenden Architekten und Ingenieure umfassend über die auf dem Schweizer Markt angebotene Software für das Bauwesen. Er enthält die wesentlichen Angaben zu mehr als 250 Programmen, die auf 11 Einsatzbe-

reiche verteilt sind. Er wird durch Anbieter- und Programmverzeichnisse vervollständigt. Zweisprachig (erscheint seit 1981), 182 Seiten.

D 504 SIA Systemkatalog CAD

Jährliche Ausgabe. Detaillierte Beschreibung der in der Schweiz erhältlichen CAD-Systeme für das Bauwesen mit neutralem Testbericht. Zweisprachig, 156 Seiten.

Fachgruppen

FVC: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Mechanischen und Thermischen Verfahrenstechnik

Am Donnerstag, dem 15. September 1988, findet in Basel, Kongresszentrum EWTCC (Schweiz. Mustermesse), Messeplatz 22, Seminarraum «Sydney», die diesjährige gemeinsame Tagung der beiden Arbeitsgruppen «Mechanische Verfahrenstechnik» und «Thermische Verfahrenstechnik» statt. Diese Tagung wird verbunden mit der Generalversammlung der SIA-Fachgruppe für Verfahrens- und Chemieingenieurtechnik (FVC) sowie der SATW-Jahrestagung 1988, die am gleichen Ort um 17.30 Uhr beginnt und am 16.9. mit dem SATW-Symposium über «Biotechnologie, eine Herausforderung für den Ingenieur» fortgesetzt wird.

Programm:

09.00 Uhr: Begrüssung durch die Arbeitsgruppenleiter (Prof. F. Widmer, Dr. D. Hody). Vorträge: Dr. L. Pedrocchi, Lonza AG, Basel: Emulsionsherstellung im turbulenten Scherspalt; B. Kegel, dipl. Ing. ETH, Gebrüder Sulzer AG Winterthur: Mikroverkapselung durch Hydropillieren. 10.15 Uhr: Pause. 10.30 Uhr: Vorträge: M. Hofer, dipl. Ing. ETH, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik/Paul Scherrer Institut, Villigen: On line - Massenseparation als Produktionsverfahren für hochreine Radionuklide; S. Egli, dipl. Ing. ETH, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik, Zürich: Entwicklung und Charakterisierung von Membranen für die Nano- und Ultrafiltration. Dr. R. Rutte, Sandoz AG, Basel: Kontinuierliche trägerfreie Elektrophorese - ein Reinigungsverfahren für Produkte hoher Wertschöpfung. 12.00 Uhr: Ende. 15.00 Uhr: Generalversammlung der SIA-FVC gemäss separater Einladung.

Kosten:

Fr. 30.- für FVC-Mitglieder, Fr. 30.- für Nichtmitglieder der FVC

Anmeldung:

SIA-Generalsekretariat, Frau S. Salamon, Selnastrasse 16, 8039 Zürich, Tel. 01/201 15 70, Telefax 01/201 63 35, und an der Tageskasse.